



$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% / 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

UWAGA:

Do klejenia izolacji termicznej używa się, w przypadku typowych podłoży budowlanych, gotowych zapraw budowlanych zapraw klejowych (mieszanych z wodą na budowie). Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne). Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

Usługi projektowe		05-600 Grójec ul. Kasztanowa 28 lok. 12 h.romanowska@gmail.com tel. 603 850 997
 mgr inż. Henryka Romanowska		
Projekt termomodernizacji budynku przedszkola		Data wyk. 07.2018
Rys.13	Sposób klejenia płyt izolacji termicznej	
Adres budowy	Odrzywół, gm. Odrzywół, dz. nr ewid. 356/3	
Projektant Nr. uprawnień Specjalność	mgr inż. arch. Tomasz Gajewski 62/91 Sk-ce specjalność architektoniczna i konstrukcyjna	
Sprawdzający Nr. uprawnień Specjalność	mgr inż. Henryka Romanowska GP-III-7342/161/92, MAZ/0017/POOK/09 specjalność architektoniczna i konstrukcyjna	
Opracowała	mgr inż. Magdalena Rosłonec	